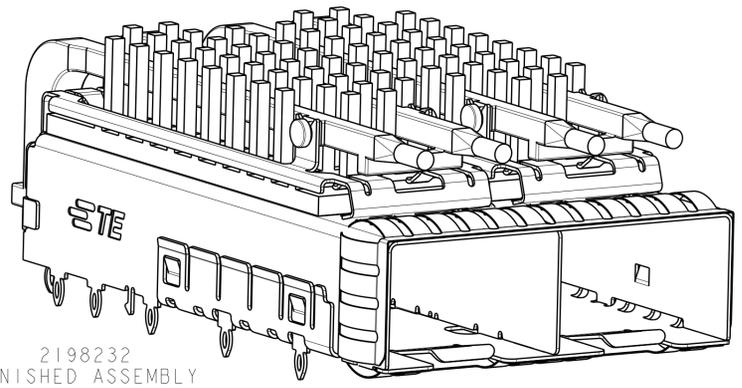


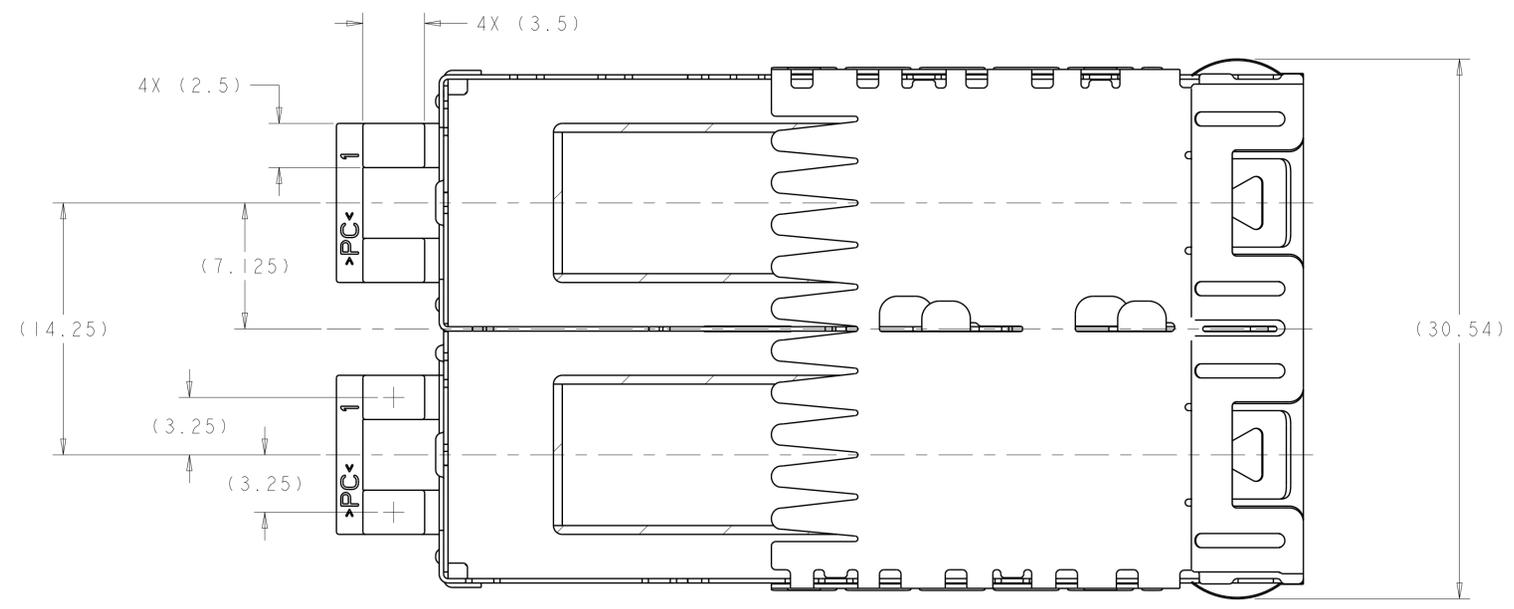
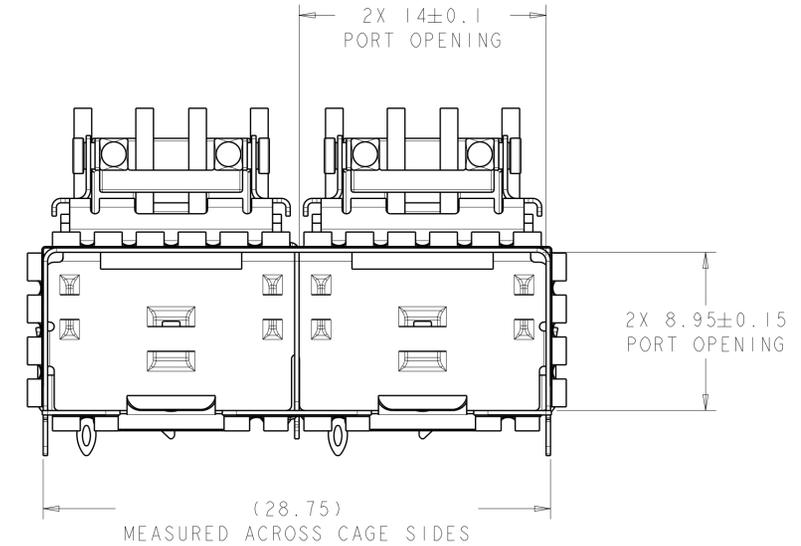
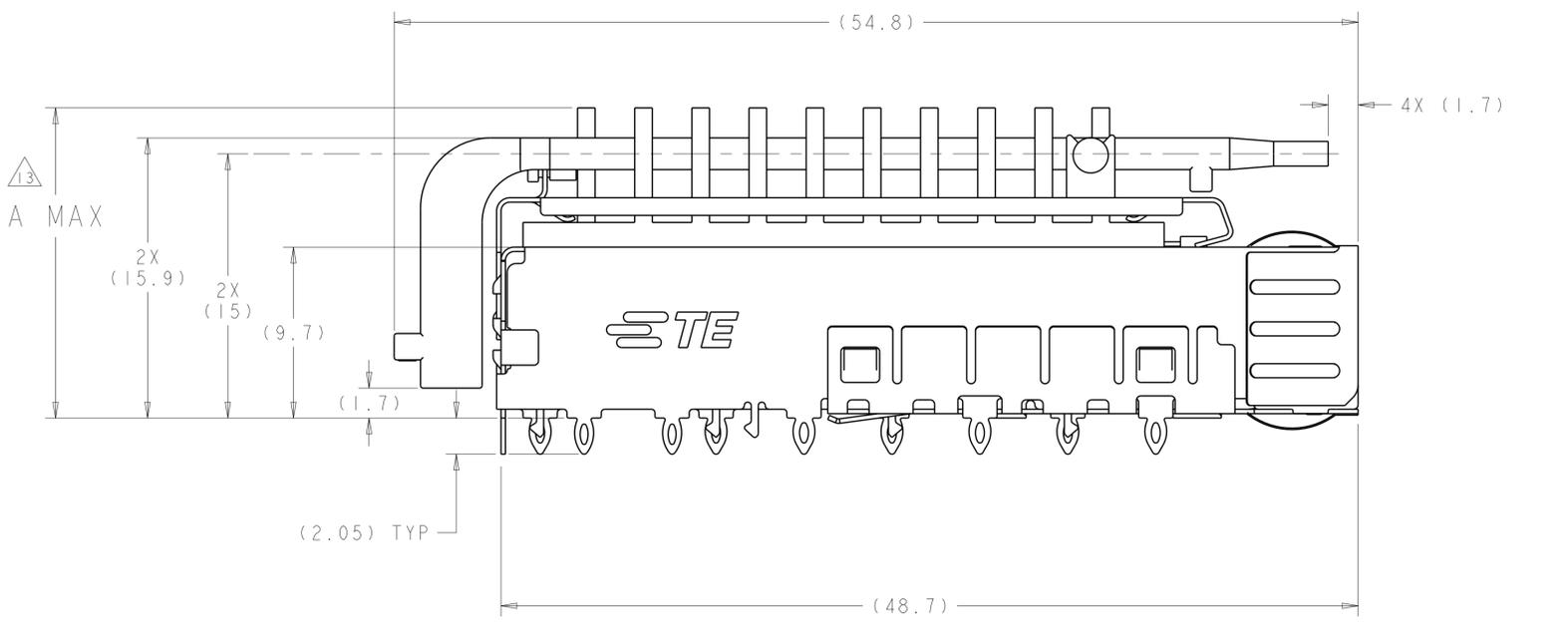
LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTN	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		A		RELEASED PER ECO-12-013192	08OCT2012	BMM	MRS
		A1		RELEASED PER ECO-14-008488	06JUNE2014	PP	SH



2198232
FINISHED ASSEMBLY
SCALE 4:1

- 1 MATERIAL:
CAGE ASSEMBLY: 0.25mm THICK NICKEL SILVER ALLOY
EMI SPRINGS: COPPER ALLOY
HEAT SINK: ALUMINUM
HEAT SINK/LIGHTPIPE CLIP: STAINLESS STEEL.
LIGHTPIPE: POLYCARBONATE, CLEAR
- 2 FINISH:
SPRINGS: MINIMUM OF 0.8um TIN PLATE OVER MINIMUM OF 0.8um NICKEL UNDERPLATE. NON-PLATED EDGES PERMISSIBLE.
HEAT SINK: ELECTROLESS NICKEL
HEAT SINK CLIP: PASSIVATE.
- 3 DATUM AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 4 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- 5 MATES WITH SFP MSA COMPLIANT RECEIVERS.
- 6 INTERPRETATION OF DATUM REFERENCE FRAME IN ACCORDANCE WITH SECT 4.4.1.1 OR ASME Y14.5M-1994.
- 7 MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED: 1.5mm
DOUBLE SIDED: 2.25mm
- 8 HOLE PATTERN REPEATS FOR EACH PORT, SPACING BETWEEN PORTS IS 14.25mm.
- 9 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.

- 10 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 11 CERTAIN MATING TRANCEIVERS MAY REQUIRE ADDITIONAL PCB THICKNESS THAT WOULD NEED TO BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.
- 12 PRODUCT COMPLIES WITH SPECIFICATION SFF-8433 IMPROVED PLUGGABLE FORM FACTOR FOR SFP+ GANGED CAGES.
- 13 DIMENSION APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE.
- 14 HEATSINK, HEATSINK CLIP, AND LIGHTPIPE SHIPPED UNASSEMBLED TO CAGE ASSEMBLY. CAGE ASSEMBLY TO BE PRESSED INTO PCB PRIOR TO ATTACHING HEATSINK, HEATSINK CLIP, AND LIGHTPIPE TO THE CAGE ASSEMBLY.
- 15 PACKAGED AS A COMPLETE ASSEMBLY.

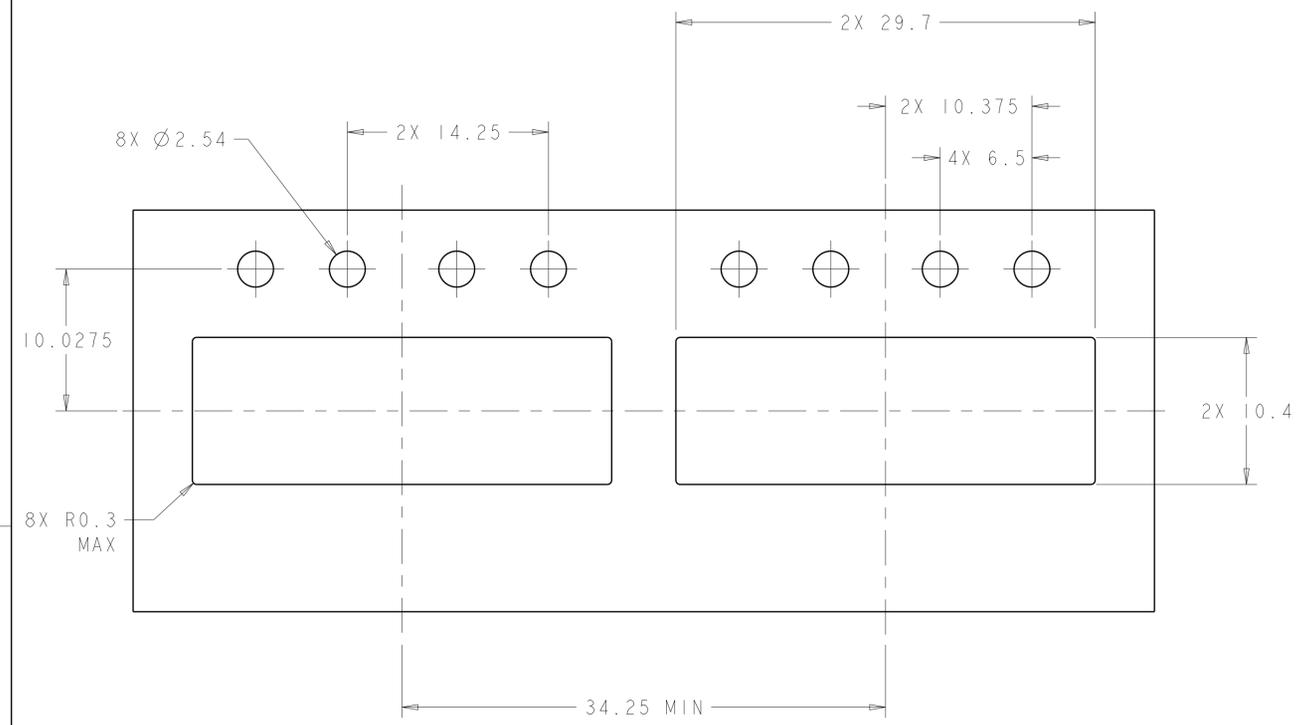


13	22.5	NETWORKING, TALL	2198232-4
13	18.1	NETWORKING, SHORT	2198232-3
14	15.5	SAN	2198232-2
14	13.2	PCI	2198232-1
	A MAX	DESCRIPTION	PART NUMBER

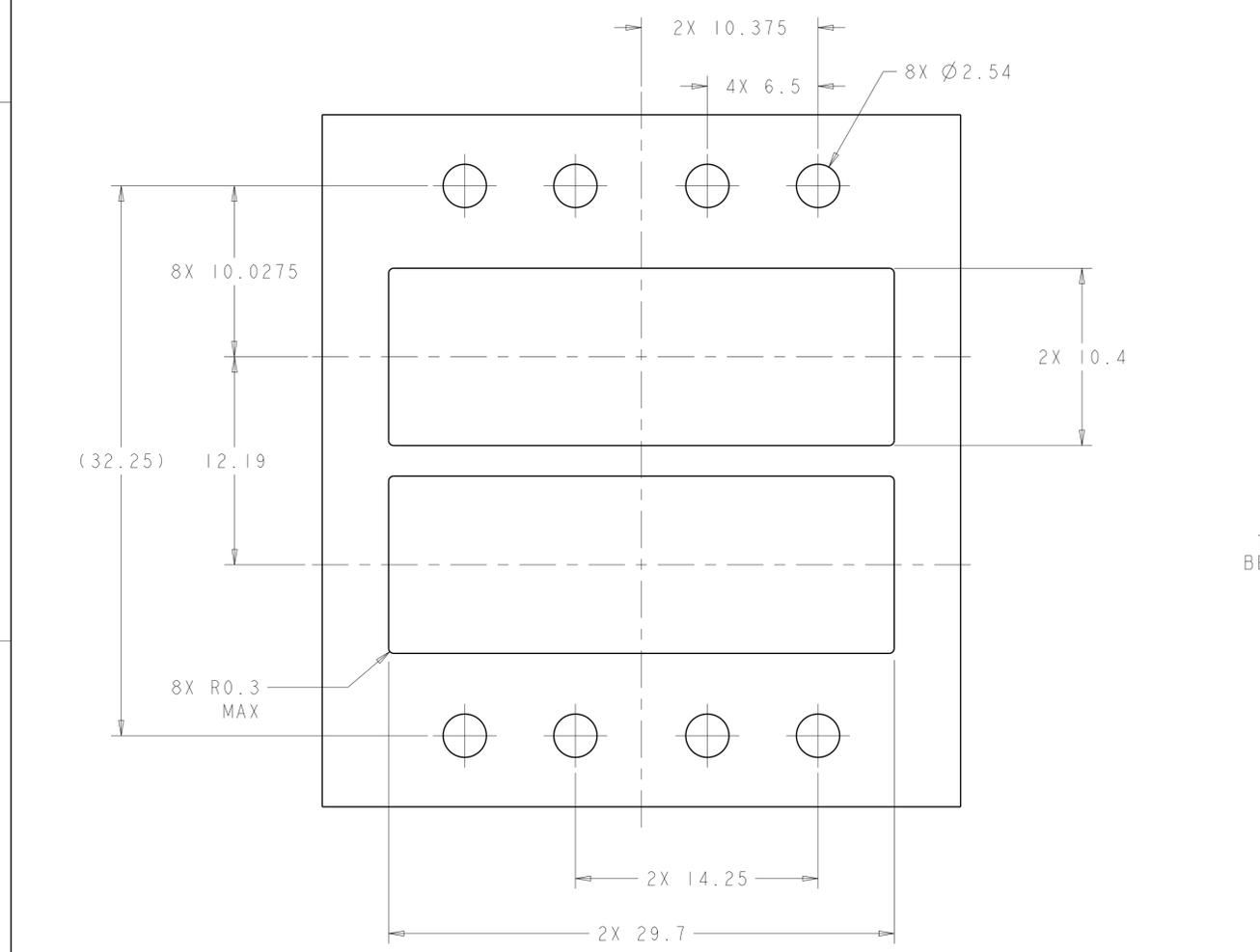
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DWN B. MATTHEWS 01NOV2011	TE Connectivity
mm	0 PLC ±0.13	CHK M. SCHMITT 01NOV2011	
	1 PLC ±0.1	APVD M. SCHMITT 01NOV2011	
	2 PLC ±0.08	NAME SFP+ ENHANCED 1X2 CAGE ASSEMBLY, PRESS-FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE	
	3 PLC ±0.05	PRODUCT SPEC 108-2364	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO
	4 PLC ±0.05	APPLICATION SPEC 114-13120	A100779C=2198232
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	SCALE 5:1 SHEET 1 OF 4 REV A1
		Customer Drawing	

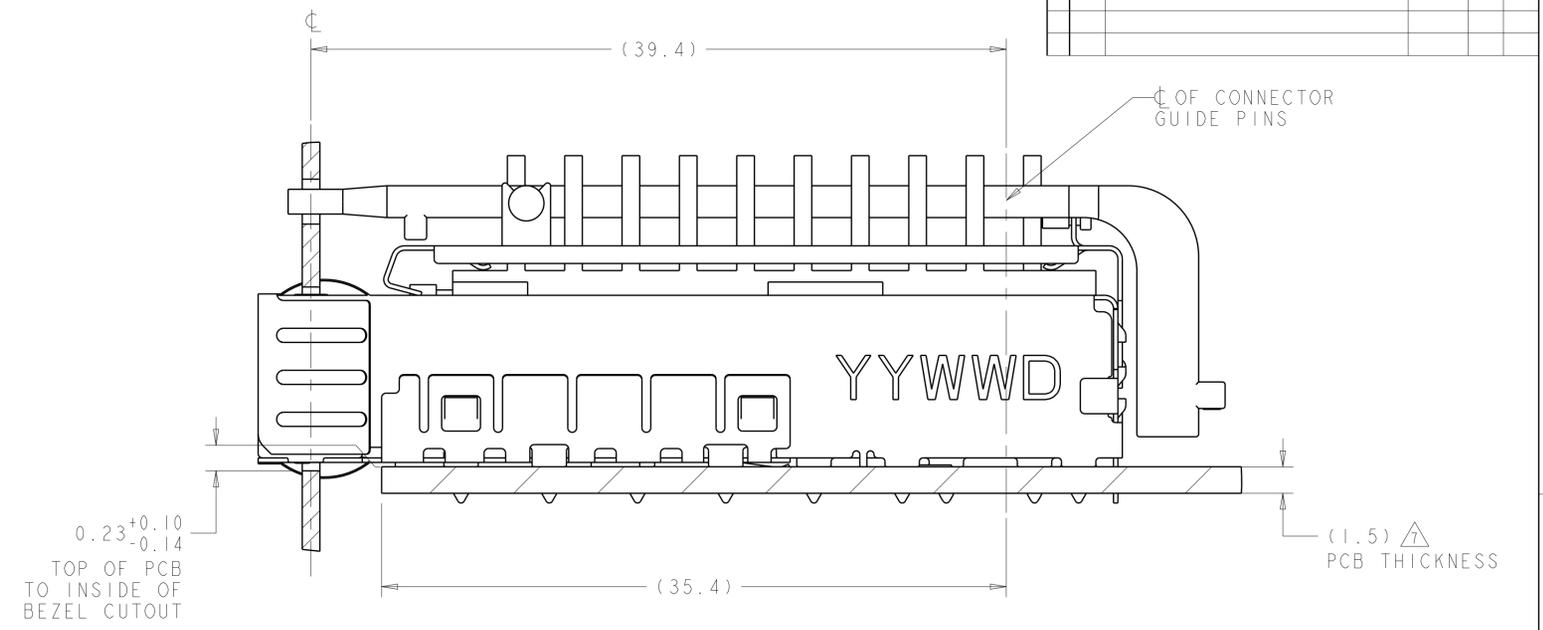
LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTN	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
-	-	-	-	SEE SHEET 1	-	-	-



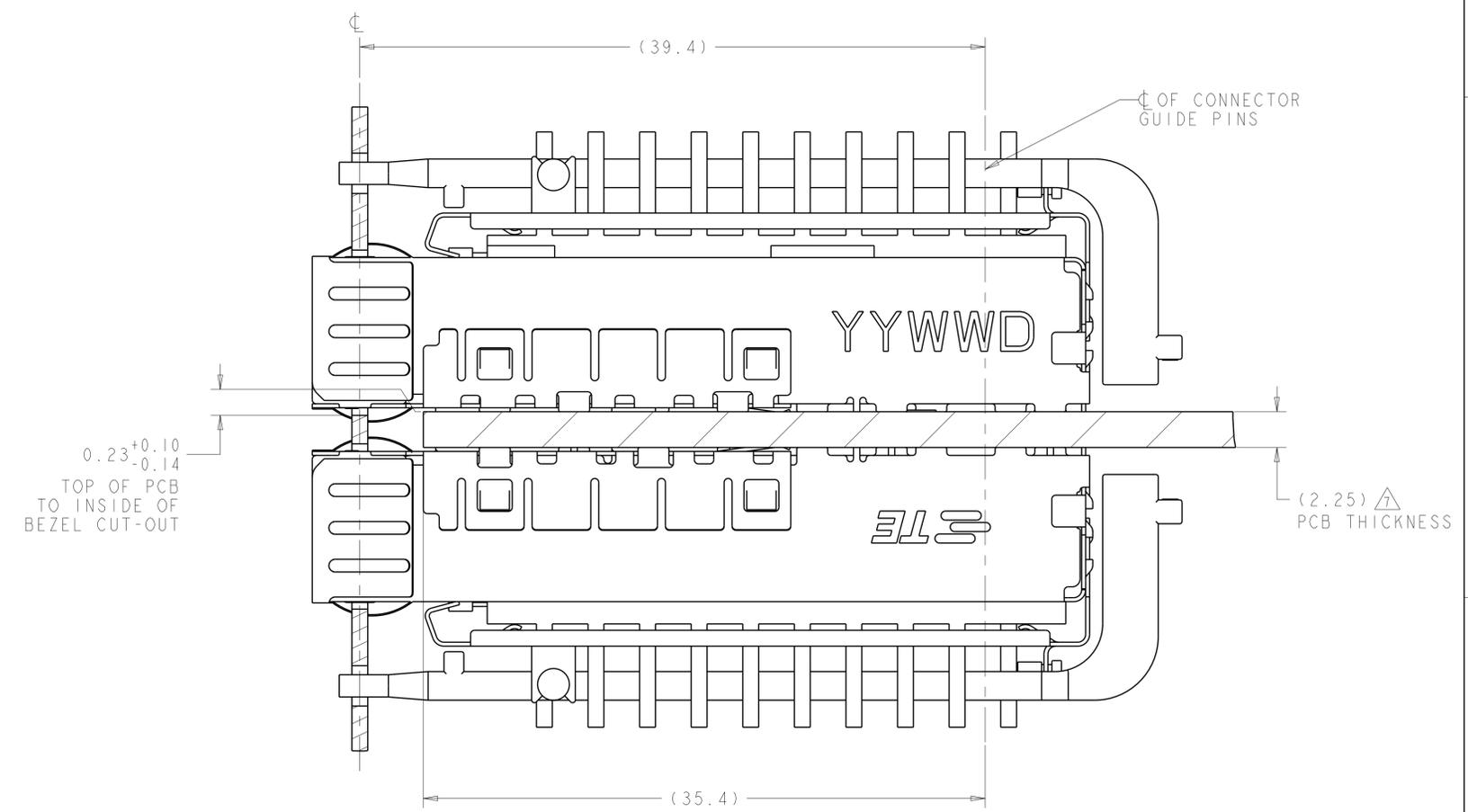
RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT
 SINGLE SIDED APPLICATIONS
 SCALE 4:1



RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT
 BELLY TO BELLY APPLICATIONS



2198232
 MOUNTED ON PC BOARD
 SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL



2198232
 MOUNTED BELLY TO BELLY ON PC BOARD
 SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN: B. MATTHEWS 01NOV2011	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK: M. SCHMITT 01NOV2011	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD: M. SCHMITT 01NOV2011	NAME: SFP+ ENHANCED 1X2 CAGE ASSEMBLY, PRESS-FIT, EXTERNAL EMI SPRINGS WITH HEATSINK AND LIGHTPIPE PRODUCT SPEC: 108-2364 APPLICATION SPEC: 114-13120
0 PLC ±0.13 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.08 3 PLC ±0.05 4 PLC ±0.05 ANGLES ±0.5		SIZE: CAGE CODE DRAWING NO: 114-13120 WEIGHT: - Customer Drawing	
MATERIAL FINISH		RESTRICTED TO	SCALE: 5:1 SHEET 2 OF 4 REV: A1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9